



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22994XA

Issue Date:17 Jul 2020

Title of Change:	Planned Capacity Expansion for SOIC 8/14 Copper Wire Products into ASE Kunshan China (ASEKS) - Phase 2. Reference to IPCN 22774X
Proposed First Ship date:	24 Oct 2020 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or albert.reyes@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Shiela.Crosby@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Materials shipped after PCN effectivity may be sourced from either qualified locations. Part marking will identify the assembly location in the trace code, and product labelling will identify the country of assembly.
Change Category:	Assembly Change, Test Change
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
ON Semiconductor Carmona, Philippines	ASEKS, China

Description and Purpose:

	Before Change Description	After Change Description	
Lead frame	AG CU	AG CU	LF AGSPOTTED
Die Attach	SUMITOMO CRM-1076WB	SUMITOMO CRM-1076WB	HITACHI EN4900GC
Bond Wire	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	NIPPON 1 mil PD Cu
Mold Compound	MC EME G600	MC EME G600	CEL9240HF10AK
Assembly Site	OSPI Carmona	OSPI Carmona	ASEKS China
Test Site	OSPI Carmona	OSPI Carmona	ASEKS China

	From	To
Product marking change	XX AYW Where : XX: device marking A : P for Carmona Site YW : two digit date code	XX AYW Where : XX: device marking A : AK for ASEKS site YW : two digit date code

**Reliability Data Summary:**

QV DEVICE NAME MC33074ADR2G

RMS O67264

PACKAGE SOIC-14

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/693
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec		0/45
PD	JESD22 B100,B108			0/30
WBS	AEC-Q100-001			0/90
WBP	Mil-Std-883 Method 2011			0/90

QV DEVICE NAME MC33272ADR2G

RMS O58055

PACKAGE SOIC-8

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/462
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec		0/45
PD	JESD22 B100,B108			0/30
WBS	AEC-Q100-001			0/90
WBP	Mil-Std-883 Method 2011			0/90

QV DEVICE NAME MC33204DR2G

RMS O58070

PACKAGE SOIC-14

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231



QV DEVICE NAME MC33179DR2G
RMS O58069, O62275
PACKAGE SOIC-14

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [**PCN Customized Portal**](#).

Part Number	Qualification Vehicle
MC33078DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33074DR2G	MC33074ADR2G
LP2951ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33072DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33079DR2G	MC33074ADR2G
LM324ADR2G	MC33074ADR2G, MC33179DR2G
SC2902DR2G	MC33074ADR2G, MC33179DR2G
MC33172DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951ACD-3.3R2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34072DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33272ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CD-3.3R2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LM201ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33072ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC1496DR2G	MC33074ADR2G
MC33179DR2G	MC33074ADR2G, MC33179DR2G
MC33074ADR2G	MC33074ADR2G
LM833DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34074DR2G	MC33074ADR2G



MC1455DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC3303DR2G	MC33074ADR2G
MC34072ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LM311DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC3403DR2G	MC33074ADR2G
MC33204DR2G	MC33074ADR2G, MC33204DR2G
MC34072VDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33174DR2G	MC33074ADR2G
MC1496BDR2G	MC33074ADR2G
LM211DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34074ADR2G	MC33074ADR2G
LM201AVDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33174VDR2G	MC33074ADR2G
MC34074VDR2G	MC33074ADR2G
MC33071DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC1455BDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33171DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33172VDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33077DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33071ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34071DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34072DG	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34071ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33204VDR2G	MC33074ADR2G, MC33204DR2G
LM301ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
NE592D14G	MC33074ADR2G
LP2951ACD-3.0R2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CD-3.0R2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951ACD-3.0G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CD-3.0G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951ACD-3.3G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CD-3.3G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22994XA

発行日: 17 Jul 2020

変更件名:	SOIC 8/14 銅ワイヤー製品の生産能力の ASE Kunshan China (ASEKS) への拡大計画 - フェーズ 2 IPCN 22774X 参照
初回出荷予定日:	24 Oct 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または albert.reyes@onsemi.com にお問い合わせください。
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.Samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。
追加の信頼性デー	お客様の地域のオン・セミコンダクター営業所または Shiela.Crosby@onsemi.com にお問い合わせください。
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com 宛てをお願いします。
変更部品の識別:	PCN 発効後に出荷される製品は、認定済み拠点のいずれかで生産されます。製品のマーキングのトレースコードで組立拠点を、製品のラベルにより組立の国を識別できます。

変更カテゴリ: アセンブリの変更, 試験の変更

変更サブカテゴリ: 製造拠点の追加

影響を受ける拠点:

オン・セミコンダクター拠点:

外部製造工場 / 下請業者拠点:

オン・セミコンダクター カルモナ (フィリピン)

ASEKS (中国)

説明および目的:

PROCESS	変更前の表記	変更後の表記	
リードフレーム	AG CU	AG CU	LF AGSPOTTED
ダイ接着剤	SUMITOMO CRM-1076WB	SUMITOMO CRM-1076WB	HITACHI EN4900GC
ボンドワイヤー	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	NIPPON 1 MIL PD Cu
モールドコンパウンド	MC EME G600	MC EME G600	CEL9240HF10AK
組立拠点	OSPI CARMONA	OSPI CARMONA	ASEKS CHINA
検査拠点	OSPI CARMONA	OSPI CARMONA	ASEKS CHINA

	変更前	変更後
製品マーキング変更	XX AYW WHERE : XX: DEVICE MARKING A : P FOR CARMONA SITE YW : TWO DIGIT DATE CODE	XX AYW WHERE : XX: DEVICE MARKING A : AK FOR ASEKS SITE YW : TWO DIGIT DATE CODE



信頼性データの要約:

デバイス名: DEVICE NAME MC33074ADR2G

RMS: O67264

パッケージ: SOIC-14

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/693
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec		0/45
PD	JESD22 B100,B108			0/30
WBS	AEC-Q100-001			0/90
WBP	Mil-Std-883 Method 2011			0/90

デバイス名: DEVICE NAME MC33272ADR2G

RMS: O58055

パッケージ: SOIC-8

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/462
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec		0/45
PD	JESD22 B100,B108			0/30
WBS	AEC-Q100-001			0/90
WBP	Mil-Std-883 Method 2011			0/90



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22994XA

発行日: 17 Jul 2020

デバイス名: DEVICE NAME MC33204DR2G

RMS: O58070

パッケージ: SOIC-14

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231

デバイス名: DEVICE NAME MC33179DR2G

RMS: O62275

パッケージ: SOIC-14

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231

電気的特性の要約: 電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
MC33078DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33074DR2G	MC33074ADR2G
LP2951ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33072DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33079DR2G	MC33074ADR2G
LM324ADR2G	MC33074ADR2G, MC33179DR2G
SC2902DR2G	MC33074ADR2G, MC33179DR2G
MC33172DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951ACD-3.3R2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34072DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33272ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CD-3.3R2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LM201ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33072ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC1496DR2G	MC33074ADR2G
MC33179DR2G	MC33074ADR2G, MC33179DR2G



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号 : FPCN22994XA

発行日: 17 Jul 2020

MC33074ADR2G	MC33074ADR2G
LM833DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34074ADR2G	MC33074ADR2G
MC1455DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC3303DR2G	MC33074ADR2G
MC34072ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LM311DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC3403DR2G	MC33074ADR2G
MC33204DR2G	MC33074ADR2G, MC33204DR2G
MC34072VDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33174DR2G	MC33074ADR2G
MC1496BDR2G	MC33074ADR2G
LM211DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34074ADR2G	MC33074ADR2G
LM201AVDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33174VDR2G	MC33074ADR2G
MC34074VDR2G	MC33074ADR2G
MC33071DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC1455BDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33171DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33172VDR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33077DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33071ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34071DR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34072DG	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC34071ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
MC33204VDR2G	MC33074ADR2G, MC33204DR2G
LM301ADR2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
NE592D14G	MC33074ADR2G
LP2951ACD-3.0R2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CD-3.0R2G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951ACD-3.0G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CD-3.0G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951ACD-3.3G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G
LP2951CD-3.3G	MC33272ADR2G, MC33074ADR2G